

股票代码：688403

股票简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年7月3日)

编号：2024-004

| | |
|-----------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | UBS Asset Management、东方基金、光大保德信基金、建信保险资管、幸福人寿、野村投资、原点资产、南土资管、上海晨燕资管、申万宏源证券、长江证券、华鑫证券、国元信托 |
| 活动时间 | 2024年7月3日 |
| 活动地点 | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 奚颢 |
| 投资者关系活 动主要内容 介绍 | <p>1、问：公司当前 OLED 驱动芯片封测业务主要客户有哪些？</p> <p>答：公司目前 OLED 客户主要包括联咏、瑞鼎、奕力、云英谷、集创北方、芯颖、傲显、昇显微、晟合微等。</p> <p>2、问：公司所封装测试的 DDIC 晶圆主要来自哪些晶圆代工 Fab 厂？</p> <p>答：公司封测业务采用 OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Testing）模式，为芯片设计公司提供封装测试服务，所封测的晶圆由客户芯片设计公司向晶圆代工 Fab 厂采购</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>后提供给公司进行封装测试，晶圆的价款由客户向晶圆厂支付，不计入公司的进料成本。在这种模式下，晶圆来源由客户芯片设计公司决定，目前公司晶圆来料主要来自中国大陆地区晶圆厂，包括晶合集成、中芯国际、华虹、联芯、和舰等，其他主要来自中国台湾地区晶圆厂，包括联电、台积电、世界先进等。</p> <p>3、问：公司主要设备国产化情况怎么样？进口设备的采购周期大概多久？</p> <p>答：公司金凸块制程当中溅射、光刻、电镀等工艺环节相当一部分主要机器由国产半导体设备厂商供应，后道制程用到的高端测试机、切割机、ILB 等设备从 ADVANTEST、DISCO 等境外厂商进口。当前公司主要采购设备进机周期大概 4-6 个月左右。</p> <p>4、问：从不同应用场景来看，下半年公司 DDIC 下游市场景气度情况怎么样？</p> <p>答：从下游应用景气度趋势来看，2024 年上半年受益于年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛，下半年在部分备货高峰时段可能亦有不错的景气度；小尺寸显示驱动芯片中部分新型应用场景的品类在本年度呈现快速增长态势，如电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等，下半年随着手机新机发布及备货增加，叠加部分客户新产品导入，有望带动中小尺寸 DDIC 景气度实现提升。</p> |
| <p>是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>不涉及</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>上传日期</p> | <p>2024 年 7 月 4 日</p> |